

EMIシールドペースト〈プラスチック筐体〉

プラスチック筐体の表面に直接塗布！

用途

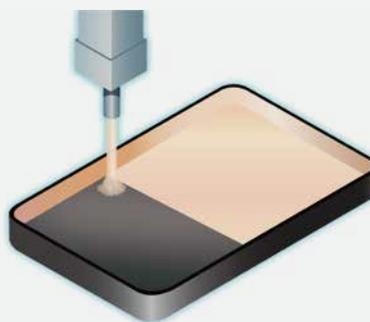
プラスチック筐体向けシールド用途

スプレー塗布機を使用し、機器のプラスチック筐体の表面に塗布。その後硬化することで、10 μ m程度のシールド層を形成します。スパッタリング等の他工法ではシールド層の形成が難しいプラスチック表面に、簡単にシールド層を形成できます。

ドライレコーダーへの塗布イメージ



塗布イメージ



特徴

- 70dBを超える優れたシールド特性
- 低温基材 (PP、PC) への高密着性
- 厚膜形成可能

プラスチック筐体（本ペースト塗布済み）



ラインナップ&特性

製品型番			AE5000L-73
タイプ			筐体シールドタイプ
粘度	E型 10rpm※	mPa・s	200±100
硬化条件	本硬化		80°C×120分 / 100°C×60分
体積抵抗率[代表値]		$\Omega \cdot \text{cm}$	1.0E-04

※ コーンプレート型粘度計 CP-40 10rpm

